

「第58回十大新製品賞 本賞」を受賞

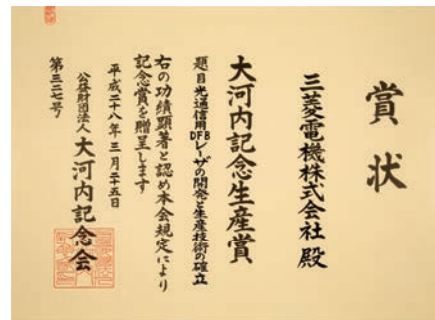
“基板穴あけ用レーザー加工機ML605GTF3-5350UM”が日刊工業新聞社が主催する“第58回十大新製品賞 本賞”を受賞した。この加工機は、スマートフォン用のプリント基板・電子部品の製造装置として高いシェアを占めている。当社が長年幅広い分野で培ってきた技術を活用して内製化した、CO₂レーザー発振器、ガルバノスキャナ、fθレンズ等のキーパーツに新たな技術を取り込み、更に性能を高めることで従来機比20%の位置決め精度や30%の生産性向上を実現したことが評価された。



「第62回大河内賞 大河内記念生産賞」を受賞

“光通信用DFBレーザーの開発と生産技術の確立”が、“第62回(平成27年度)大河内賞 大河内記念生産賞”を受賞した。世界的にブロードバンド通信が普及し、光通信ネットワークが拡大の一途をたどる中、光通信に用いられる半導体レーザー、中でもDFB(Distributed FeedBack)レー

ザの需要が増加している。当社高周波光デバイス製作所は、1980年代から光通信用DFBレーザーとその生産技術の開発に取り組んでおり、その高い性能と信頼性、及び安定した大量生産を可能にする優れた生産技術が評価された。



「第48回市村産業賞 功績賞」を受賞

“3.3kVフルSiC適用鉄道車両用推進制御装置”で、“第48回市村産業賞 功績賞”を受賞した。3.3kVフルSiC(シリコンカーバイド)モジュールを鉄道車両用推進制御装置に世界で初めて(*)適用し、SiCパワーデバイスが鉄道車両駆動システムの省エネルギーと推進装置の小型化に極めて有効であることを実証したことが評価された。今後、鉄道分野に限らず、民生、産業、自動車、電力など広範な分野で

SiC適用機器の開発が加速され、これらの機器の普及拡大による地球規模での省エネルギーへの貢献が期待される。

この研究の一部は、経済産業省及び国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の委託を受けて実施した。

*1 2014年4月30日現在、当社調べ

